(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/304

(11) 공개번호 특1995-0015631
(43) 공개일자 1995년06월17일

(21) 출원번호 특1994-0031394
(22) 출원일자 1994년11월26일
(30) 우선권주장 93-321201 1993년11월26일 일본(JP)
(71) 출원인 세이코세이키 가부시키가이샤 다카키 도시요시
일본국 치바켄 나라시노시 야시키 4쵸메 3반 1고
(72) 발명자 아다치 다다시
일본국 치바켄 나라시노시 야시키 4쵸메 3반 1고 세이코세이키 가부시키가이샤 내
(74) 대리인 김연수

심사청구 : 없음

(54) 다이싱 머신

요약

본 발명의 다이싱 머신은 반도체 웨이퍼가 부착된 캐리어프레임을 적재하는 다수의 스토커와, 하나의 캐리어 프레임을 그 사이즈에 매칭하는 위치에 위치시키는 프리얼라이먼트와, 상기 프리얼라이먼트와 상기 스토커 중의 하나 사이에 반도체 웨이퍼를 이동시키는 핸들링 유닛과, 가공 테이블과, 반도체 웨이퍼를 운반하는 로더와, 상기 가공 테이블 상에서 반도체 웨이퍼를 절단하는 절단 블레이드로 구성된다. 상기 캐리어 프레임의 사이즈가 변경되면, 상기 가공테이블 상에서 작동 흡착 영역은 또 다른 흡착 영역으로 전환된다. 상기 로더는 캐리어 프레임을 흡입하는 진공 패드의 위치를 변경시킨다. 본 발명은 취급할 캐리어 프레임의 사이즈가 변경되어도 단시간내에 용이하게 그 상황에 대처할 수 있으므로, 생산성을 향상시킨다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

다이싱 머신

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 일실시예에 따른 다이싱 머신의 주요부의 배열을 도시한 도면이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

캐리어 프레임들에 고정된 다수의 반도체 웨이퍼를 적재하는 두 개의 스토커와; 하나의 반도체 웨이퍼가 부착된 상기 캐리어 프레임중의 하나가 배치되며, 상기 캐리어 프레임의 사이즈에 매칭되는 위치에 상기 캐리어 프레임을 위치시키는 위치결정수단을 구비한 위치결정 테이블과; 가공되지 않은 반도체 웨이퍼가 부착된 캐리어프레임을 상기 스토커 중의 한 스토커로부터 가져오는 한편, 상기 위치결정 테이블로부터 가공 반도체 웨이퍼가 부착된 캐리어 프레임을 끌어내어 상기 스토커중의 하나에 안치시키는 반도체 웨이퍼 핸들링유닛과; 상기 반도체 웨이퍼가 부착된 하나의 캐리어 프레임을 흡착하는 다수의 흡착 영역을 가지는 가공테이블과; 반도체 웨이퍼가 부착된 캐리어 프레임을 고정시키는 고정수단과 상기 캐리어 프레임의 사이즈에 따라 상기 고정수단의 위치를 변경시키는 고정위치 변경수단을 가지는 반도체 웨이퍼 운반수단과; 상기 가공 테이블상에 고정된 반도체 웨이퍼를 절단하는 절단 수단을 구비하고, 상기 가공 테이블에는 캐리어 프레임의 사이즈에 따라서 작동 흡착 영역을 전환하는 흡착영역 전환수단을 추가로 설치하고, 상기 반도체 웨이퍼 운반수단은 가공되지 않은 반도체 웨이퍼가 부착된 캐리어 프레임을 상기 고정수단에 의해 고정시키고, 이를 상기 위치결정 테이블로부터 상기 가공 테이블로 운반하는 한편, 가공된 반도체 웨이퍼가 부착된 케리어 프레임을 상기 고정수단에 의해 고정시키고 이를 상기 가공테이블로부터 상기 위치결정 테이블로 운반하도록 작동하는 것을 특징으로 하는 다이싱 머신.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

